

2017-2023年中国LED封装行业市场全景评估及发展趋势预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2023年中国LED封装行业市场全景评估及发展趋势预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/321035.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

LED封装即将上一环节的LED芯片封装成单颗成品，保护芯片以防止其长期暴露或损坏，能起到稳定芯片性能、提高光取出率与发光效率、提高使用寿命的作用。并且，封装环节的技术与资金门槛较低，又与市场联系最紧密，成为我国在LED生产中发展最快的一环。

LED封装步骤

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章LED封装相关概述

1.1LED封装简介

1.1.1LED封装作用

1.1.2LED封装的形式

1.1.3LED封装的结构类型

1.1.4LED封装的工艺流程

1.1.5LED封装对封装材料要求

1.2LED封装的常见要素

1.2.1LED引脚成形方法

1.2.2LED弯脚及切脚

1.2.3LED清洗

1.2.4LED过流保护

1.2.5LED焊接条件

第二章2013-2015年中国LED封装产业整体运营态势分析

2.12013-2015年世界LED封装业的发展总况

2.1.1世界LED封装业发展规模及应用

2.1.2世界LED封装企业分析

2.1.3世界LED封装技术先进性分析

2.22013-2015年中国LED封装业的发展综述

2.2.1中国LED封装业发展成果

2.2.2 产值增长情况 LED封装产值走势

2.2.3 产量增长情况

2.2.4 价格分析

2.2.5 利好因素

2.3 2013-2015年国内重要LED封装项目的建设进展

2.3.1 韩企投资扬州兴建LED封装基地

2.3.2 西安经开区LED封装线项目投产

2.3.3 长治高科LED封装项目竣工投产

2.3.4 敬亭园中园LED支架及封装项目开建

2.3.5 源力光电LED封装线正式投产

2.4 SMDLED封装

2.4.1 SMDLED封装市场发展简况

2.4.2 SMDLED封装技术壁垒较高

2.4.3 SMDLED封装产能尚未过剩

2.4.4 SMDLED封装受益于芯片价格下降

2.5 2013-2015年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨

2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素

2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战

2.5.3 封装业销售额与海外企业差距明显

2.5.4 传统封装工艺成为系统成本瓶颈

2.6 促进中国LED封装业发展的策略

2.6.1 做大做强LED封装产业的对策

2.6.2 发展LED封装行业的措施建议

2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入

2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2013-2015年中国LED封装市场新格局透析

3.1 2013-2015年中国LED封装市场发展态势

3.1.1 中国成中低端LED封装重要基地

3.1.2 国内LED封装企业发展不平衡

3.1.3 中国LED封装市场缺乏大型企业

3.1.4 LED产业上游厂商涉足封装市场

3.1.5 台湾LED封装产能向大陆转移

3.2 中国LED封装企业分布状况

3.2.1 2013年LED封装企业区域分布

3.2.2 2014年LED封装企业区域分布

3.3 广东省LED封装业

3.3.1 主要特点

3.3.2 重点市场

3.3.3 发展趋势

第四章 2013-2015年中国LED封装行业技术研发进展状况

4.1 中外LED封装技术的差异

4.1.1 封装生产及测试设备差异

4.1.2 LED芯片差异

4.1.3 封装辅助材料差异

4.1.4 封装设计差异

4.1.5 封装工艺差异

4.1.6 LED器件性能差异

4.2 中国LED封装技术发展概况

4.2.1 封装技术影响LED产品可靠性

4.2.2 中国LED业专利集中在封装领域

4.2.3 中国LED封装业的技术特点

4.2.4 LED封装技术水平不断提升

4.2.5 LED封装业技术研发仍需加强

4.3 LED封装关键技术介绍

4.3.1 大功率LED封装的关键技术

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2013-2015年中国LED封装设备及封装材料的发展

5.1 LED封装设备市场分析

5.1.1 我国LED封装设备市场概况

5.1.2 LED封装设备国产化亟需加速

5.1.3 发展我国LED封装设备业的思路

5.2 LED封装材料市场分析

5.2.1 LED封装主要原材介绍

5.2.2 我国LED封装材料市场简析

5.2.3 部分关键封装原材料仍依赖进口

5.2.4 LED封装用基板材料市场走向分析

5.3 LED封装支架市场

5.3.1 国内LED封装支架市场格局分析

5.3.2 LED封装支架技术未来发展趋势

5.3.3 我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 2013-2015年中国LED封装产业竞争新形态分析

6.1 2013-2015年中国LED封装市场竞争格局

6.1.1 中国采购影响世界封装市场格局

6.1.2 我国LED封装市场各方力量简述

6.1.3 国内LED封装市场竞争加剧

6.1.4 本土LED封装企业整合步伐加速

6.2 2013-2015年中国LED封装企业竞争力简析

6.2.1 2015年本土封装企业竞争力排名

6.2.2 2015年本土LED封装企业竞争力排名

6.3 2017-2023年中国LED封装竞争趋势预测分析

第七章 2013-2015年全球LED封装顶尖企业分析

7.1 科锐 (CREE)

7.1.1 企业概况

7.1.2 企业LED封装运营态势

7.1.3 企业发展战略分析

7.2 日亚化学 (NICHIA)

7.2.1 企业概况

7.2.2 企业LED封装运营态势

7.2.3 企业发展战略分析

7.3 飞利浦 (Philips)

7.3.1 企业概况

7.3.2 企业LED封装运营态势

7.3.3 企业发展战略分析

7.4 三星LED (SamsungLED)

7.4.1 企业概况

7.4.2 企业LED封装运营态势

7.4.3 企业发展战略分析

7.5 首尔半导体 (SSC)

7.5.1企业概况

7.5.2企业LED封装运营态势

7.5.3企业发展战略分析

第八章2013-2015年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析

8.1亿光电子

8.1.1企业概况

8.1.2企业LED封装运营态势

8.1.3企业发展战略分析

8.2光宝集团

8.2.1企业概况

8.2.2企业LED封装运营态势

8.2.3企业发展战略分析

8.3东贝光电

8.3.1企业概况

8.3.2企业LED封装运营态势

8.3.3企业发展战略分析

8.4宏齐科技

8.4.1企业概况

8.4.2企业LED封装运营态势

8.4.3企业发展战略分析

8.5台积电

8.5.1企业概况

8.5.2企业LED封装运营态势

8.5.3企业发展战略分析

8.6艾笛森

8.6.1企业概况

8.6.2企业LED封装运营态势

8.6.3企业发展战略分析

第九章2013-2015年中国内地主要LED封装重点企业

9.1国星光电（002449）

9.1.1企业概况

9.1.2企业主要经济指标分析

9.1.3企业盈利能力分析

9.1.4企业偿债能力分析

9.1.5企业运营能力分析

9.1.6企业成长能力分析

9.2雷曼光电

9.1.1企业概况

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

9.1.2企业LED封装运营态势

9.1.3企业发展战略分析

9.3鸿利光电

9.1.1企业概况

(一) 企业偿债能力分析

(二) 企业运营能力分析

(三) 企业盈利能力分析

9.1.2企业LED封装运营态势

9.1.3企业发展战略分析

9.4大族光电(002008)

9.4.1企业概况

9.4.2企业主要经济指标分析

9.4.3企业盈利能力分析

9.4.4企业偿债能力分析

9.4.5企业运营能力分析

9.4.6企业成长能力分析

9.5深圳市瑞丰光电子有限公司

9.5.1企业概况

9.5.2企业主要经济指标分析

9.5.3企业盈利能力分析

9.5.4企业偿债能力分析

9.5.5企业运营能力分析

9.5.6企业成长能力分析

9.6宁波升谱光电半导体有限公司

9.6.1企业概况

9.6.2企业主要经济指标分析

9.6.3企业盈利能力分析

9.6.4企业偿债能力分析

9.6.5企业运营能力分析

9.6.6企业成长能力分析

9.7南京汉德森科技股份有限公司

9.7.1企业概况

9.7.2企业主要经济指标分析

9.7.3企业盈利能力分析

9.7.4企业偿债能力分析

9.7.5企业运营能力分析

9.7.6企业成长能力分析

第十章2017-2023年中国LED封装产业发展趋势及前景

10.12017-2023年LED封装产业未来发展趋势

10.1.1功率型白光LED封装技术发展趋势

10.1.2LED封装技术将向模块化方向发展

10.1.3LED封装产业未来发展走向分析

10.22017-2023年中国LED封装市场前景展望

10.2.1我国LED封装市场发展前景乐观

10.2.2LED封装产品应用市场将持续扩张

10.2.3中国LED通用照明封装市场规模预测

第十一章2017-2023年中国LED封装产业投资前景预测

11.12017-2023年中国LED封装行业投资概况

11.1.1LED封装行业投资特性

11.1.2LED封装具有良好的投资价值

11.1.3LED封装投资环境利好

11.22017-2023年中国LED封装投资机会分析

11.2.1LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）

11.2.2国家节能减排衍生LED封装投资机会

11.32017-2023年中国LED封装投资风险及防范

11.3.1技术风险分析

11.3.2金融风险分析

11.3.3政策风险分析

11.3.4竞争风险

11.4专家建议

略.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/321035.html>